



FlipChip Typenreihen

Platinmesswiderstände in FC-Bauform

Für die automatische Bestückung auf Leiterplatten durch Löten oder Bonden

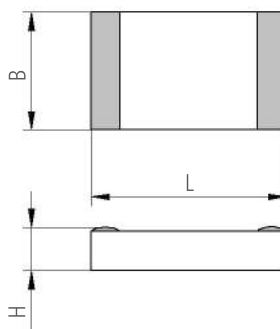


INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

Vorteile & Eigenschaften

- Ausgezeichnete Langzeitsstabilität
- Minimaler Platzverbrauch auf PCB
- Kurze Ansprechzeit
- Geringe Eigenerwärmung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bondbare Versionen erhältlich
- Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Illustration¹⁾



1) Genaue Grösse unter Abmessungen zu finden

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich:	1FC	-50 °C bis +150 °C
	2FC	-50 °C bis +250 °C
	3FC	-50 °C bis +250 °C
	5FC	-50 °C bis +400 °C
	6FC	-50 °C bis +600 °C
	Nennwiderstand:*	100 Ω bei 0 °C
500 Ω bei 0 °C		
1000 Ω bei 0 °C		
Temperaturkoeffizient:*	3850 ppm/K	
Langzeitstabilität:	< 0.04 % nach 1000 h bei +130 °C	
Toleranzklasse (abhängig von Temperaturbereich):*	IST AG Referenz	
	DIN EN 60751 F0.3	B
	DIN EN 60751 F0.6	C
Anschluss:*	1FC	Verzinkt (96.5Sn/3Ag/0.5Cu), LMP bleifrei, reflow lötlbar
	2FC	Verzinkt (5Sn/93.5Pb/1.5Ag), HMP, reflow lötlbar
	3FC	Au-Pads (bondbare Pads); verschiedene Typen erhältlich
	5FC	Verstärkte Dünnschicht Pt-Pads (lötlbare Pads)
	6FC	Dickschicht Pt-Pads (schweisbar)



FlipChip Typenreihen

Platinmesswiderstände in FC-Bauform

Für die automatische Bestückung auf Leiterplatten durch löten oder bonden



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

Lötbarkeit: ¹⁾ <small>1) Lötprozess kann die Genauigkeit beeinflussen</small>	235 °C ≤ 8 s (DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth. 1) - 1FC, 2FC, 5FC
Lötwärmebeständigkeit:	260 °C 10 s (DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth. 1A) - 1FC, 2FC, 5FC
Empfohlener Messstrom: ²⁾ <small>2) Eigenerwärmung muss berücksichtigt werden</small>	1 mA bei 100 Ω 0.5 mA bei 500 Ω 0.3 mA bei 1000 Ω
Alternativer Aufbau:*	Metallisierte Rückseite Substratdicke
Verpackung:	< 100 Stk. in Chiptrays > 100 Stk. gegurtet > 100 Stk. auf Folie

* Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Bestellangaben - 1FC (Verzinkt (96.5Sn/3Ag/0.5Cu), LMP bleifrei)

Grösse Abmessungen (L x B x H in mm) F0.3 (Klasse B)

In Chiptrays verpackt (< 100 Stk.)

Nennwiderstand: 100 Ω bei 0 °C

0603	1.5 x 0.75 x 0.4	POK1.0603.1FC.B
Bestellnummer		310.00655
0805	2 x 1.5 x 0.4	POK1.0805.1FC.B
Bestellnummer		010.02586

Nennwiderstand: 500 Ω bei 0 °C

0805	2 x 1.5 x 0.4	POK5.0805.1FC.B
Bestellnummer		010.02705

Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C

0603	1.5 x 0.75 x 0.4	P1K0.0603.1FC.B
Bestellnummer		310.00656
0805	2 x 1.5 x 0.4	P1K0.0805.1FC.B
Bestellnummer		010.02557

Gegurtet (> 100 Stk.)

Nennwiderstand: 500 Ω bei 0 °C

0805	2 x 1.5 x 0.4	Aktive Sensorfläche nach unten	POK5.0805.1FC.B.S
Bestellnummer			010.02706



FlipChip Typenreihen

Platinmesswiderstände in FC-Bauform

Für die automatische Bestückung auf Leiterplatten durch löten oder bonden



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

Grösse Abmessungen (L x B x H in mm) F0.3 (Klasse B)

Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C

0805	2 x 1.5 x 0.4	Aktive Sensorfläche nach unten	P1K0.0805.1FC.B.S
Bestellnummer			010.02558

Auf Folie (> 100 Stk.)

Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C

0805	2 x 1.5 x 0.4		P1K0.0805.1FC.B.S
Bestellnummer			010.02602

Bestellangaben - 2FC (Verzinkt, Lötdepot, HMP, 5Sn/93.5Pb/1.5Ag)

Auf Anfrage

Bestellangaben - 3FC (Au-Pads (bondbare Pads); verschiedene Typen erhältlich)

Grösse Abmessungen (L x B x H in mm) F0.3 (Klasse B)

In Chiptrays verpackt (< 100 Stk.)

Nennwiderstand: 100 Ω bei 0 °C

0805	2 x 1.5 x 0.4		POK1.0805.3FC.B
Bestellnummer			310.00536

1206	3.0 x 1.6 x 0.4		POK1.1206.3FC.B
Bestellnummer			310.00499

Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C

0603	1.5 x 0.75 x 0.4		POK1.0805.3FC.B
Bestellnummer			310.00653

0805	2 x 1.5 x 0.4		P1K0.0805.3FC.B
Bestellnummer			010.02749

161	1.6 x 1.2 x 0.25		P1K0.161.3FC.B
Bestellnummer			010.01863



FlipChip Typenreihen

Platinmesswiderstände in FC-Bauform

Für die automatische Bestückung auf Leiterplatten durch löten oder bonden



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

Grösse	Abmessungen (L x B x H in mm)	F0.3 (Klasse B)
Auf Folie (> 100 Stk.)		
Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C		
0805	2 x 1.5 x 0.4	POK1.0805.3FC.B.S
Bestellnummer		010.02717

Bestellangaben - 5FC (verstärkte Dünnschicht Pt-Pads)

Auf Anfrage

Bestellangaben - 6FC (Dickschicht Pt-Pads)

Grösse	Abmessungen (L x B x H in mm)	F0.3 (Klasse B)
Nennwiderstand: 1000 Ω bei 0 °C		
161	2 x 1.5 x 0.4	P1K0.161.6FC.B
Bestellnummer		010.00626

Zusätzliche Dokumente

	Dokumentname:
Application Note:	ATP_E



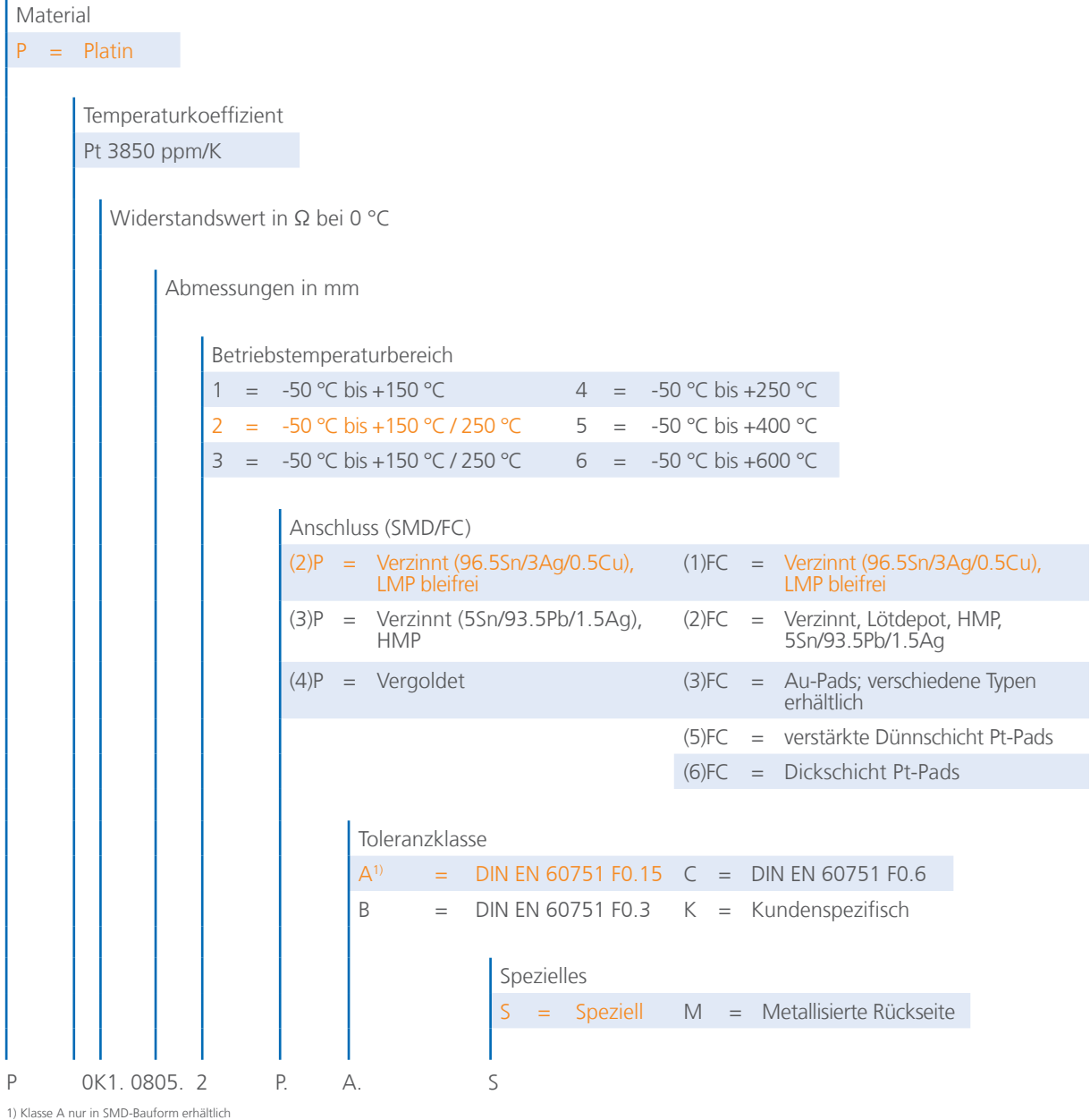
Bestellhinweise

Platinmesswiderstände in FC- Bauform

Sekundärreferenz



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

Innovative Sensor Technology IST AG, Stegrütistrasse 14, CH-9642 Ebnat-Kappel, Switzerland,
Phone: +41 (0) 71 992 01 00 | Fax: +41 (0) 71 992 01 99 | E-mail: info@ist-ag.com | Web: www.ist-ag.com



Alle mechanischen Abmessungen gelten bei 25 °C Umgebungstemperatur, falls nicht anders angegeben • Alle Daten ausser die mechanischen Abmessungen dienen nur Informationszwecken und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen • Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung sowie Irrtümer vorbehalten • Die Informationen auf diesem Datenblatt wurden sorgfältig überprüft und werden als richtig angenommen • Keine Haftung bei Irrtümern • Belastung mit Extremwerten über einen längeren Zeitraum kann die Zuverlässigkeit beeinflussen • Alle Rechte, insbesondere die elektronische kommerzielle Vervielfältigung, vorbehalten • Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, die Inhalte dieses Datenblattes im Ganzen oder Teile daraus in elektronische Datenbanken, Internet oder auf CDROM zu vervielfältigen • Technische Änderungen bleiben vorbehalten.